

<<LED照明设计与应用>>

图书基本信息

书名：<<LED照明设计与应用>>

13位ISBN编号：9787030253224

10位ISBN编号：7030253221

出版时间：2009-10

出版时间：科学

作者：LED照明推进协会

页数：156

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<LED照明设计与应用>>

内容概要

本书是一部关于LED照明系统的普及读物，主要由五个重要的部分组成，即基础篇、测试方法篇、设计指南篇、应用篇和资料篇。

本书可帮助读者全方位了解LED的工作原理、测试方法、设计原理与应用等方面的知识。

书中通过大量的插图与表格对内容进行深入浅出的论述，使之达到了通俗易懂、简明扼要的效果。

本书可作为照明相关领域的专业参考书，对希望全面系统掌握LED照明知识的人士，也将是一本不可多得的专业科普读物。

<<LED照明设计与应用>>

书籍目录

第1章 基础篇 1.1 LED的历史 1.1.1 砷(As)系的化合物半导体LED~GaAs系的红外LED及AlGaAs系的红光LED 1.1.2 砷(As)、磷(P)系化合物半导体LED~GaAsP系红光LED 1.1.3 磷(P)系化合物半导体LED~GaP系绿光LED 1.1.4 磷(P)系的四元混晶化合物半导体LED~AlGaInP系橙色光LED 1.1.5 氮(N)系化合物半导体LED~GaN系蓝光LED、绿光LED 1.1.6 氮(N)系化合物半导体LED~GaN系白光LED 1.2 LED的发光原理(半导体的发光原理与性质) 1.2.1 什么是LED(发光二极管) 1.2.2 发光二极管与白炽灯有何不同 1.2.3 发光原理 1.2.4 发光波长的分布 1.3 白光的原理 1.3.1 何为白光 1.3.2 白光LED的实现方法 1.4 LED光源的特点 1.4.1 实现白光LED的方法 1.4.2 光学特性 1.4.3 电气特性 1.4.4 可靠性等 1.4.5 其他 1.5 LED封装的构造与构成材料 1.5.1 LED封装的构造 1.5.2 构成材料 1.6 LED结晶生长法 1.6.1 LED工作层(功能层)的生长法 1.6.2 外延生长用单晶衬底 1.7 LED光源的制造方法 1.7.1 成型——LED电极成型工艺 1.7.2 LED芯片的成型 1.7.3 LED光源的成型工序第2章 测试方法篇 2.1 电气特性相关的标准和测试方法 2.1.1 正向电流 2.1.2 正向电压 2.1.3 反向电流 2.1.4 反向电压 2.1.5 端子间电容量第3章 设计指南篇第4章 应用篇第5章 资料篇

<<LED照明设计与应用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>